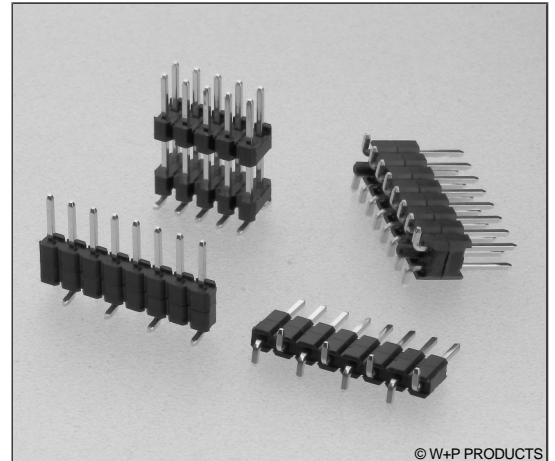


9533 / 9133

SMT-Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-reihig SMT Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, Single/Double Row

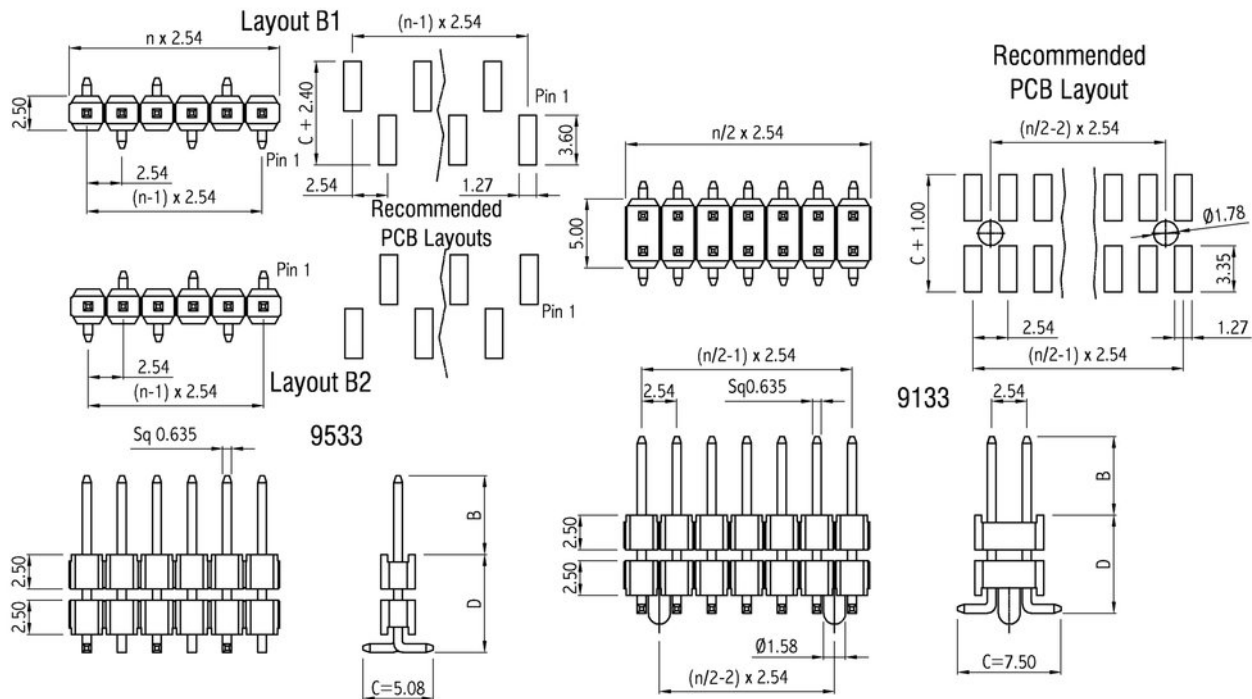
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.635mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
Test Voltage	1 kV DC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +125 °C
Temperature Range	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
3490 3491 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*	Layout*	Loc. Pegs*	Packaging*
9533	14	08	50	2	00	PPST
Gestanzte/geprägte Kontakte	14 B=5,7 D=6,3mm	03-40 Einreihig Single row	00 Vergoldet Gold plated	0 (Nur Serie 9133) (9133 series only)	00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs	ST
Stamped/formed contacts	15 B=5,7 D=7,1mm	41-80 Zweireihig Double row	50 Verzinkt Tin plated	1 Layout B1 (9533)	10 Mit Pos.hilfen (9133) With loc. pegs (9133)	PPST
9533 Einreihig Single row	99 Kundenspezifisch Customer-specific		60 Sel. Au/Sn Duplex plating	2 Layout B2 (9533)		PPTR (Option)
9133 Zweireihig Double row						

Weitere Stiftlängen und Veredelungen auf Anfrage.
More pin length and plating options on request.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

